

光電コパッケージ技術の概要と シリコンフォトニクス内蔵パッケージ基板の開発・今後の課題

1名分料金で
2人目無料セミナーURLはこちら→ <https://www.rdsc.co.jp/seminar/2501101>

- ◆日時: 2025年01月21日(火) 10:00~12:00
- ◆【アーカイブ配信受講: 1/22(水)~1/29(水)】を希望される方は、
⇒ <https://www.rdsc.co.jp/seminar/2501101A> こちらからお申し込み下さい。
- ◆受講料: 1名につき44,000円(税込、資料付)

会員(案内)登録していただいた場合、通常1名様申込で44,000円(税込)から
 ・1名で申込の場合、**38,500円(税込)**へ割引になります。
 ・2名同時申込で両名とも会員登録をいただいた場合、**計44,000円(2人目無料)**です

セミナーお申込みFAX

03-5857-4812

※お申込み確認後は弊社よりご連絡いたします。

- 講師: 国立研究開発法人 産業技術総合研究所
プラットフォームフォトニクス研究センター 光実装研究チーム
主任研究員 Ph.D. 乗木 暁博 氏 【ご専門】半導体製造・光実装技

【講演の趣旨】

近年、データセンターや大規模科学計算、AIシステムにおいて、より大容量、低遅延、低電力な信号入出力が半導体パッケージに求められています。このような背景のもと、高速信号伝送のボトルネックとなっていた電気配線を除去する技術として光電コパッケージが注目されています。光電コパッケージ技術は超小型の光トランシーバを半導体パッケージ内部に集積する技術です。これにより高速信号伝送に優れた光信号を半導体パッケージで扱えるようになり、その信号入出力を劇的に高速化できると期待されています。

本セミナーではそのような光電コパッケージ技術の概要や世界的な動向、技術的ポイントについて解説します。また、次世代の光電コパッケージにむけて産総研で技術開発を進めている光IC内蔵パッケージ基板について、そのコンセプトから要素技術開発、試作デモの結果について紹介します。

【プログラム】

1. 光電コパッケージ技術の概要
 - 1.1. 光電コパッケージが求められる背景
 - 1.2. 光電コパッケージの性能指標
 - 1.3. 光電コパッケージの主な課題
 - 1.4. 世界的な光電コパッケージの取り組み
2. シリコンフォトニクス内蔵パッケージ基板の開発
 - 2.1. シリコンフォトニクス内蔵パッケージ基板の概要
 - 2.2. 要素技術
 - (1) マイクロミラー
 - (2) シングルモードポリマー導波路
 - (3) 光IC埋め込み技術
 - (4) 光コネクタ
 - 2.3. パッケージ基板の試作
 - (1) 熱解析
 - (2) 試作と信号伝送評価結果
 - 2.4. 今後の課題

『光電コパッケージ』セミナー申込書※ご希望の参加形式にチェックを入れて下さい⇒LIVE/アーカイブ

会社・大学			
住所	〒		
電話番号		FAX	

● セミナーの受講申込みについて ●

必要事項をご明記の上、FAXでお申込み下さい。弊社で確認後、必ず受領のご連絡をいたします。受講用URLは後日お送りいたします。

セミナーお申込み後のキャンセルは基本的にお受けしておりませんので、ご都合により出席できなくなった場合は代理の方がご出席ください。

お申込み・振込に関する詳細はHPをご覧ください。
⇒ <https://www.rdsc.co.jp/pages/entry>

個人情報保護方針の詳細はHPをご覧ください。
⇒ <https://www.rdsc.co.jp/pages/privacy>

会員登録(無料) ※案内方法を選択してください。複数選択可。

Eメール 郵送